(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年4月6日(06.04.2023)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2023/053717 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2022/029907

(22) 国際出願日： 2022年8月4日(04.08.2022)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2021-161296 2021年9月30日(30.09.2021) JP

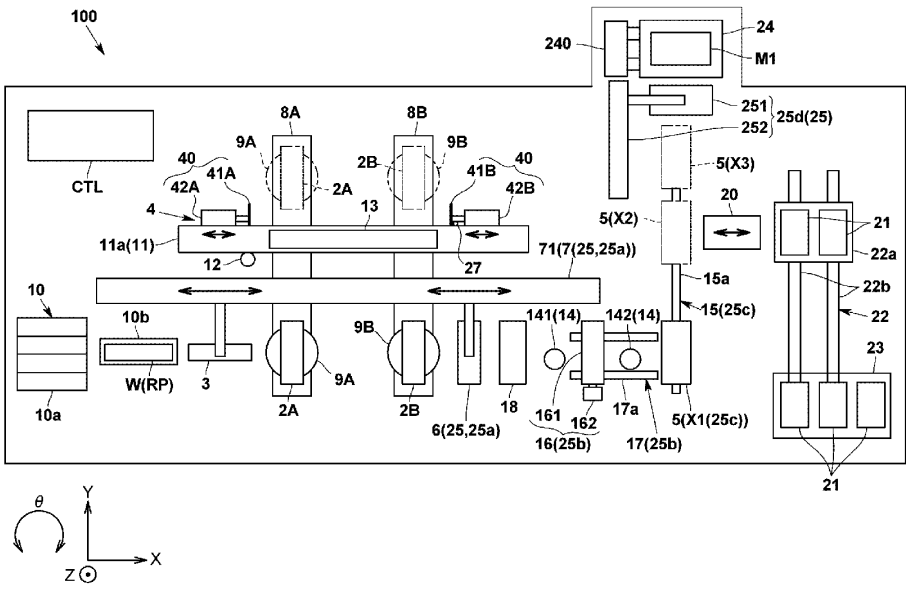
(71) 出願人：ＴＯＷＡ株式会社 (**TOWA CORPORATION**) [JP/JP]；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者：深井 元樹(**FUKAI, Motoki**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 Kyoto (JP). 今井 一郎(**IMAI, Ichiro**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 Kyoto (JP). 大西 将馬(**ONISHI, Shoma**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 Kyoto (JP). 山本 裕子(**YAMAMOTO, Yuko**)；〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 ＴＯＷＡ株式会社内 Kyoto (JP).

(74) 代理人：西村 竜平，外(**NISHIMURA, Ryuhei** et al.)；〒6008441 京都府京都市下京区四条町３４７番地１ ＣＵＢＥ西烏丸９階 Kyoto (JP).

(54) **Title:** PROCESSING DEVICE AND PROCESSED ARTICLE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称： 加工装置、及び加工品の製造方法



(57) **Abstract:** The present invention is for automatically replacing a holding plate for holding a processing-target object, and provides a processing device 100 that holds a sealed board W on processing tables 2A, 2B, and processes the sealed board W by a processing mechanism 4 while moving the processing tables 2A, 2B. The processing device 100 comprises: a plate housing part 24 that houses a holding plate M1 for holding the sealed board W; a holding base part M2 on which the holding plate M1 is mounted attachably thereto/detachably therefrom and which holds the sealed board W by using

WO 2023/053717 A1

［続葉有］

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

the holding plate M1; and a plate conveying mechanism 25 that conveys the holding plate M1 between the plate housing part 24 and the holding base part M2. The plate conveying mechanism 25 conveys the holding plate M1 detached from the holding base part M2 to the plate housing part 24 and conveys the holding plate M1 located at the plate housing part 24 to the holding base part M2.

(57) 要約：本発明は、加工対象物を保持するための保持用プレートを自動的に交換するものであり、加工用テーブル２Ａ、２Ｂに封止済基板Ｗを保持し、加工用テーブル２Ａ、２Ｂを移動させながら、加工機構４により封止済基板Ｗを加工する加工装置１００であって、封止済基板Ｗを保持するための保持用プレートＭ１を収容するプレート収容部２４と、保持用プレートＭ１が着脱可能に取り付けられ、保持用プレートＭ１を用いて封止済基板Ｗを保持する保持ベース部Ｍ２と、保持用プレートＭ１をプレート収容部２４及び保持ベース部Ｍ２の間で搬送するプレート搬送機構２５とを備え、プレート搬送機構２５は、保持ベース部Ｍ２から取り外された保持用プレートＭ１をプレート収容部２４に搬送し、プレート収容部２４にある保持用プレートＭ１を保持ベース部Ｍ２に搬送する。